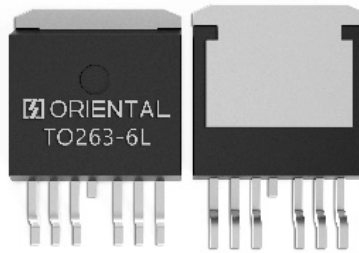


TO263-6L

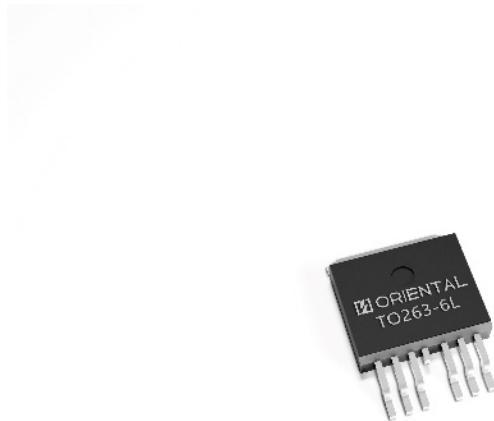
1、封装结构：

TO263-6L 采用表面贴装设计，具有 6 个引脚，其中包含一个用于散热的金属底座（Tab）。这种封装通过底部焊盘与 PCB 直接连接，实现良好的散热性能，适用于大电流、高功率的应用场景。



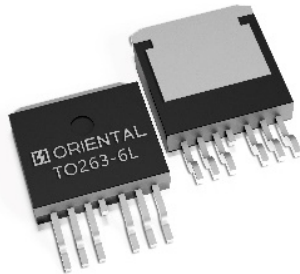
2、散热性能：

金属底座直接与 PCB 接触，可有效降低热阻，提高散热效率，适合处理较高功率的电路，如工业电源、电动汽车充电器、光伏逆变器等。



3、电气特性：

支持较高的电流承载能力(通常可达数十安培),并能承受一定的电压应力,常用于中高压(如 40V-1200V)功率转换电路。



4、应用领域：

广泛应用于电源管理、电机驱动、新能源汽车、工业自动化等领域，尤其适用于需要紧凑布局和高效散热的场景。